



上海硅产业集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易实施情况
暨新增股份上市公告书（摘要）

独立财务顾问



二〇二五年十一月

上市公司声明

本部分所述词语或简称与本上市公司公告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。

1、本公司及全体董事、高级管理人员保证本上市公司公告书摘要内容的真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。

2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公司公告书摘要中所引用的相关数据真实、准确、完整。

3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本上市公司公告书摘要内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部信息披露文件。投资者若对本上市公司公告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

4、本上市公司公告书摘要所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。

5、本公司提醒投资者注意：本上市公司公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上交所官方网站。

特别提示

一、本次发行仅指本次交易中发行股份及支付现金购买资产部分的股份发行，募集配套资金部分的股份将另行发行。

二、本次发行新增股份的发行价格为 15.01 元/股。

三、本次发行新增股份上市数量为 447,405,494 股。本次发行完成后公司股份数量为 3,194,582,680 股。

四、本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份已于 2025 年 11 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

五、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。

目 录

上市公司声明	1
特别提示	2
目 录	3
释 义	4
第一节 本次交易的基本情况	7
一、本次交易方案概述	7
二、本次交易具体方案	8
三、本次交易构成重大资产重组	17
四、本次交易构成关联交易	18
五、本次交易不构成重组上市	19
第二节 本次交易的实施情况	20
一、本次交易决策过程和批准情况	20
二、本次交易的实施情况	20
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异	22
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况	22
五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被持股 5%以上主要股东或其他关联人占用的情形，或上市公司为持股 5%以上股东及其关联人提供担保的情形	23
六、相关协议及承诺的履行情况	23
七、本次交易后续事项的合规性及风险	23
第三节 中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见	24
一、独立财务顾问意见	24
二、法律顾问意见	24

释 义

本公告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

本上市公告书摘要/本公告书摘要	指	《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）》
上市公告书	指	《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》
上市公司、公司、沪硅产业	指	上海硅产业集团股份有限公司
海富半导体基金	指	海富半导体创业投资（嘉兴）合伙企业（有限合伙）
晶融投资	指	共青城晶融投资合伙企业（有限合伙）
产业基金二期	指	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
上海闪芯	指	上海闪芯企业管理合伙企业（有限合伙）
中建材新材料基金	指	中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）
上海国际投资	指	上海国际集团投资有限公司，曾用名上海上国投资资产管理有限公司，已于 2025 年 8 月 26 日变更为现名称
混改基金	指	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司
交易对方	指	海富半导体基金、晶融投资、产业基金二期、上海闪芯、中建材新材料基金、上海国际投资、混改基金
交易双方	指	上市公司及交易对方
新昇晶投	指	上海新昇晶投半导体科技有限公司
新昇晶科	指	上海新昇晶科半导体科技有限公司
新昇晶睿	指	上海新昇晶睿半导体科技有限公司
标的公司	指	新昇晶投、新昇晶科、新昇晶睿
标的资产	指	新昇晶投 46.7354%股权、新昇晶科 49.1228%股权、新昇晶睿 48.7805%股权
本次交易、本次重组	指	沪硅产业拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方购买其持有的新昇晶投 46.7354%股权、新昇晶科 49.1228%股权、新昇晶睿 48.7805%股权，并向不超过 35 名（含 35 名）特定投资者发行股份募集配套资金
本次发行股份及支付现金购买资产	指	沪硅产业拟通过发行股份及支付现金的方式向交易对方购买其持有的新昇晶投 46.7354%股权、新昇晶科 49.1228%股权、新昇晶睿 48.7805%股权
本次发行股份购买资产	指	本次发行股份及支付现金购买资产中，上市公司拟以发行股份方式购买交易对方所持部分标的资产的行为及安排
本次发行股份募集配套资金、本次募集配套资金	指	沪硅产业向不超过 35 名（含 35 名）特定投资者发行股份募集配套资金
上海新昇	指	上海新昇半导体科技有限公司
产业投资基金	指	国家集成电路产业投资基金股份有限公司
国盛集团	指	上海国盛（集团）有限公司
过渡期	指	自评估基准日（不含评估基准日当日）至交割日（含交割日当日）止的期间

评估基准日	指	2024 年 12 月 31 日
审计基准日	指	2024 年 12 月 31 日
定价基准日	指	上市公司第二届董事会第二十六次会议决议公告日
交割日	指	交易对方向上市公司转让标的资产的工商变更登记手续完成，标的资产登记至上市公司名下之日；自交割日起，标的资产的所有权利、义务和风险转移至上市公司
发行日	指	上市公司向交易对方发行的新增股份登记在交易对方名下之日
审计报告	指	立信出具的《上海新昇晶投半导体科技有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字【2025】第 ZA10182 号）、《上海新昇晶科半导体科技有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字【2025】第 ZA10183 号）、《上海新昇晶睿半导体科技有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字【2025】第 ZA10181 号）
评估报告、资产评估报告、《资产评估报告》	指	中联评估出具的《上海硅产业集团股份有限公司拟以发行股份等方式购买资产所涉及的上海新昇晶投半导体科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中联评报字【2025】第 0627 号）、《上海硅产业集团股份有限公司拟以发行股份等方式购买资产所涉及的上海新昇晶科半导体科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中联评报字【2025】第 0628 号）、《上海硅产业集团股份有限公司拟以发行股份等方式购买资产所涉及的上海新昇晶睿半导体科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中联评报字【2025】第 0629 号）
备考审阅报告	指	立信出具的《上海硅产业集团股份有限公司审阅报告及备考财务报表》（信会师报字【2025】第 ZA13939 号）
《购买资产协议》	指	《上海硅产业集团股份有限公司与海富半导体创业投资（嘉兴）合伙企业（有限合伙）关于上海新昇晶投半导体科技有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》《上海硅产业集团股份有限公司与共青城晶融投资合伙企业（有限合伙）关于上海新昇晶投半导体科技有限公司之股权转让协议》《上海硅产业集团股份有限公司与国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司关于上海新昇晶科半导体科技有限公司之发行股份购买资产协议》《上海硅产业集团股份有限公司与上海闪芯企业管理合伙企业（有限合伙）关于上海新昇晶科半导体科技有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》《上海硅产业集团股份有限公司与中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）关于上海新昇晶睿半导体科技有限公司之发行股份购买资产协议》《上海硅产业集团股份有限公司与上海上国投资管理有限公司关于上海新昇晶睿半导体科技有限公司之发行股份购买资产协议》《上海硅产业集团股份有限公司与中国国有企业混合所有制改革基金有限公司关于上海新昇晶睿半导体科技有限公司之发行股份购买资产协议》的单称或合称
《购买资产补充协议》	指	《上海硅产业集团股份有限公司与海富半导体创业投资（嘉兴）合伙企业（有限合伙）关于上海新昇晶投半导体科技有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《上海硅产业集团股份有限公司与共青城晶融投资合伙企业（有限合伙）关于上海新昇晶投半导体科技有限公司之股权转让协议之补充协议》《上海硅产业集团股份有限公司与国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司关于上海新昇晶科半导体科技有限公司之发行股份购买资产协议之补充协议》《上海硅产业集团股份有限公司与上海闪芯企业管理合伙企业（有限合伙）关于上海新昇晶科半导体科技有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《上海硅产业集团

		股份有限公司与中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）关于上海新昇晶睿半导体科技有限公司之发行股份购买资产协议之补充协议》《上海硅产业集团股份有限公司与上海上国投资管理有限公司关于上海新昇晶睿半导体科技有限公司之发行股份购买资产协议之补充协议》《上海硅产业集团股份有限公司与中国国有企业混合所有制改革基金有限公司关于上海新昇晶睿半导体科技有限公司之发行股份购买资产协议之补充协议》的单称或合称
本次重组相关协议	指	《购买资产协议》《购买资产补充协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2023年12月29日经第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修订通过，自2024年7月1日起施行）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019年12月28日经第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订通过，自2020年3月1日起施行）
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法（2025年修正）》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》
《26号格式准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2025修订）》
《公司章程》	指	《上海硅产业集团股份有限公司章程》
中金公司、独立财务顾问	指	中国国际金融股份有限公司
嘉源、法律顾问	指	北京市嘉源律师事务所
立信、审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中联评估、评估机构	指	中联资产评估集团有限公司
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元

除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。本公告书摘要所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，均指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

第一节 本次交易的基本情况

一、本次交易方案概述

本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但最终募集配套资金成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。本次交易方案的概况如下：

交易形式		发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	
交易方案简介		上市公司拟向海富半导体基金发行股份及支付现金购买其持有的新昇晶投43.9863%股权，拟向晶融投资支付现金购买其持有的新昇晶投2.7491%股权，拟向产业基金二期发行股份购买其持有的新昇晶科43.8596%股权，拟向上海闪芯发行股份及支付现金购买其持有的新昇晶科5.2632%股权，拟向中建材新材料基金发行股份购买其持有的新昇晶睿24.8780%股权，拟向上海国际投资发行股份购买其持有的新昇晶睿14.6341%股权，拟向混改基金发行股份购买其持有的新昇晶睿9.2683%股权，并向不超过35名（含35名）特定投资者发行股份募集配套资金。	
交易价格(不含募集配套资金金额)		7,039,621,536.73元	
交易标的的一	名称	上海新昇晶投半导体科技有限公司	
	主营业务	持股平台，除直接持有新昇晶科50.8772%的股权及通过新昇晶科间接持有新昇晶睿51.2195%股权外，无其他实质性业务	
	所属行业	制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-电子元件及电子专用材料制造（C3985）	
	其他	符合板块定位	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
		属于上市公司的同行业或上下游	☒ 是 ☐ 否
		与上市公司主营业务具有协同效应	☒ 是 ☐ 否
交易标的的二	名称	上海新昇晶科半导体科技有限公司	
	主营业务	主要从事300mm半导体硅片切磨抛与外延相关业务	
	所属行业	制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-电子元件及电子专用材料制造（C3985）	
	其他	符合板块定位	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
		属于上市公司的同行业或上下游	☒ 是 ☐ 否
		与上市公司主营业务具有协同效应	☒ 是 ☐ 否
交易标的的三	名称	上海新昇晶睿半导体科技有限公司	
	主营业务	主要从事300mm半导体硅片拉晶相关业务	
	所属行业	制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-电子元件及电子专用材料制造（C3985）	

其他	符合板块定位	☒ 是 ☐ 否
	属于上市公司的同行业或上下游	☒ 是 ☐ 否
	与上市公司主营业务具有协同效应	☒ 是 ☐ 否
交易性质	构成关联交易	☒ 是 ☐ 否
	构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组	☒ 是 ☐ 否
	构成重组上市	☐ 是 ☒ 否
本次交易有无业绩补偿承诺		☐ 有 ☒ 无
本次交易有无减值补偿承诺		☐ 有 ☒ 无
其他需特别说明的事项	本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过35名（含35名）特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过210,500.00万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。最终发行数量将在本次交易经上交所审核通过并经中国证监会注册后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定。本次募集配套资金拟用于补充流动资金、支付本次交易的现金对价及中介机构费用。本次募集配套资金以本次发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但募集配套资金成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。	

二、本次交易具体方案

（一）发行股份及支付现金购买资产具体方案

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份购买资产发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上交所。

2、发行方式和发行对象

本次发行股份购买资产采用向特定对象发行股份的方式，发行对象为海富半导体基金、产业基金二期、上海闪芯、中建材新材料基金、上海国际投资和混改基金。

3、交易金额及对价支付方式

根据中联评估出具的《资产评估报告》，截至评估基准日 2024 年 12 月 31 日，新昇晶投股权全部权益的评估值为 396,180.83 万元；新昇晶科股权全部权益的评估值为 776,800.00 万元；新昇晶睿股权全部权益的评估值为 281,300.00 万元。

基于上述评估结果，经公司与交易对方协商一致，新昇晶投 46.7354%股权的交易价格为 1,851,566,765.64 元，新昇晶科 49.1228%股权的交易价格为 3,815,859,649.13 元，新昇晶睿 48.7805%股权的交易价格为 1,372,195,121.96 元。上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式支付本次重组交易对价，其中以发行股份的方式支付对价 6,715,556,526.75 元，以支付现金的方式支付对价 324,065,009.98 元。上市公司向交易对方支付的交易对价及支付方式具体如下：

单位：元、股

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	支付方式				向该交易对方支付总对价	向该交易对方发行的股份数量
			现金对价	股份对价	可转债对价	其他		
1	海富半导体基金	新昇晶投 43.9863% 股权	174,265,107.35	1,568,385,966.19	无	无	1,742,651,073.54	104,489,404
2	晶融投资	新昇晶投 2.7491% 股权	108,915,692.10	-	无	无	108,915,692.10	-
3	产业基金二期	新昇晶科 43.8596% 股权	-	3,407,017,543.86	无	无	3,407,017,543.86	226,983,180
4	上海闪芯	新昇晶科 5.2632% 股权	40,884,210.53	367,957,894.74	无	无	408,842,105.27	24,514,183
5	中建材新材料基金	新昇晶睿 24.8780% 股权	-	699,819,512.20	无	无	699,819,512.20	46,623,551
6	上海国际投资	新昇晶睿 14.6341% 股权	-	411,658,536.59	无	无	411,658,536.59	27,425,618
7	混改基金	新昇晶睿 9.2683% 股权	-	260,717,073.17	无	无	260,717,073.17	17,369,558
合计			324,065,009.98	6,715,556,526.75	无	无	7,039,621,536.73	447,405,494

上市公司将在本次募集配套资金的配套资金到位之日起三十个工作日内完成本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价支付。若在交割日起六个月内，本次募集配套资金未能成功实施（包括但不限于募集配套资金未能获得上交所审核通过或中国证监会同意注册或虽通过中国证监会同意注册但特定对象款项未能在规定期限内到账以及其他募集配套资金未能到位的情形），则上市公司应以自有或自筹资金先行向交易对方支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价。

4、定价基准日和发行价格

(1) 定价基准日

本次发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第二届董事会第二十六次会议决议公告日。

(2) 发行价格

根据《重组管理办法》第四十六条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日的公司股票交易均价具体情况如下表所示：

单位：元/股		
区间	交易均价	交易均价的 80%
定价基准日前 20 个交易日	18.76	15.01
定价基准日前 60 个交易日	19.78	15.83
定价基准日前 120 个交易日	21.20	16.96

注：市场参考价的 80% 的计算结果向上取整至小数点后两位。

经交易双方协商，本次发行股份及支付现金购买资产涉及的股份发行价格为 15.01 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，符合《重组管理办法》的相关规定。

自本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照如下公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0-D+A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的发行价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的发行价格。

5、发行价格调整机制

为应对市场及行业因素造成的上市公司股价波动对本次交易可能产生的影响，根据《重组管理办法》的规定，本次交易拟引入发行股份购买资产的发行价格调整机制如下：

（1）价格调整方案对象

调整对象为本次发行股份购买资产的发行价格，标的资产的价格不进行调整。

（2）发行价格调整方案生效条件

上市公司股东大会审议通过本次价格调整方案。

（3）可调价期间

上市公司审议同意本次交易的股东大会决议公告日（不含当日）至本次交易获得中国证监会同意注册前（不含当日）。

（4）触发条件

可调价期间内，出现下述任一情形的，上市公司董事会有权根据上市公司股东大会的授权召开会议审议是否对发行股份购买资产的发行价格进行调整：

1) 向下调价触发条件

同时满足下列条件的，向下调整价格：A、科创 50 指数（000688.SH）和半导体行业指数（886063.WI）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日（包括本数，下同）较上市公司因本次交易召开首次董事会前一交易日收盘点数跌幅达到或超过 20%；B、上市公司股价在任一交易日前的连续 30 个交易日中，有至少 20 个交易日较上市公司因本次交易召开首次董事会前一交易日收盘价跌幅达到或超过 20%。

2) 向上调价触发条件

同时满足下列条件的，向上调整价格：A、科创 50 指数（000688.SH）和半导体行业指数（886063.WI）在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较上市

公司因本次交易召开首次董事会前一交易日收盘点数涨幅达到或超过 20%；B、上市公司股价在任一交易日前的连续 30 个交易日中，有至少 20 个交易日较上市公司因本次交易召开首次董事会前一交易日收盘价涨幅达到或超过 20%。

（5）调价基准日

可调价期间内，调价触发条件满足的首个交易日当日。调价触发日与调价基准日为同一日。

（6）调整方式

当调价基准日出现时，上市公司有权在调价基准日出现后 20 个交易日（不含调价基准日当日）内召开董事会，审议决定是否按照价格调整方案对股份发行价格进行调整。

董事会审议决定对股份发行价格进行调整的，调整后的本次股份发行价格以调价基准日为新的定价基准日，调整后的本次股份发行价格不低于新定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日（不包括调价基准日当日）的公司股票交易均价之一的 80%，并由各方协商一致后书面确定调整后的发行价格，调整后的股份发行价格无须提交上市公司股东大会再次审议。可调价期间内，上市公司仅可对股份发行价格进行一次调整，若上市公司已召开董事会审议决定对股份发行价格进行调整，再次触发价格调整时，不再进行调整。若上市公司董事会审议决定不对股份发行价格进行调整，则后续亦不可再对本次发行股份购买资产的股份发行价格进行调整。

（7）发行数量调整

发行价格调整后，因标的资产的定价不变，故调整后的发行股份数量=股份支付对价金额/调整后的股份发行价格。

（8）调价基准日至发行日期间除权、除息事项

在调价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，将按照上交所的相关规则对调整后的股份发行价格进行调整，股份发行数量再作相应调整。

6、发行股份的数量

本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行数量将按照下述公式确定：发行股份总数量=以发行股份方式向交易对方支付的交易对价/本次发行股份购买资产的股份发行价格。

按上述公式计算的交易对方取得新增股份数量按照向下取整精确至股，不足一股的部分视为交易对方对上市公司的捐赠，直接计入上市公司资本公积。

根据标的资产的交易作价、本次发行股份购买资产的价格及股份支付的比例，本次发行股份购买资产的股份发行数量为 447,405,494 股，占本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的比例约为 14.01%，具体情况如下：

序号	交易对方	股份对价金额（元）	股份发行数量（股）
1	海富半导体基金	1,568,385,966.19	104,489,404
2	产业基金二期	3,407,017,543.86	226,983,180
3	上海闪芯	367,957,894.74	24,514,183
4	中建材新材料基金	699,819,512.20	46,623,551
5	上海国际投资	411,658,536.59	27,425,618
6	混改基金	260,717,073.17	17,369,558
合计		6,715,556,526.75	447,405,494

发行股份数量最终以经上市公司股东大会审议通过，经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为准。

在本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或根据前述发行价格调整机制调整发行价格，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。

7、锁定期安排

海富半导体基金、产业基金二期、上海闪芯、中建材新材料基金、上海国际投资和混改基金作为本次发行股份购买资产的交易对方，就认购的上市公司股份锁定期承诺如下：

“1、本企业因本次交易取得的上市公司新增股份自本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。

2、本次交易完成后，本企业通过本次交易取得的上市公司股份由于上市公司派息、送股、资本公积转增股本、配股等原因增加的，所增加的股份亦应遵守上述锁定期约定。

3、若上述锁定期安排与证券监管机构的最新规定及监管要求不相符，本企业将根据证券监管机构的最新规定及监管意见进行相应调整。

4、上述锁定期届满后，本企业转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。”

8、滚存利润安排

上市公司本次发行完成前的滚存未分配利润，将由本次发行完成后的新老股东自本次发行完成日起按照在登记结算公司登记的股份比例共同享有。

9、过渡期损益归属

标的资产在过渡期内产生的损益由上市公司享有或承担。

10、决议有效期

与本次发行股份及支付现金购买资产方案有关的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册文件，则该有效期自动延长至本次交易实施完成之日。

（二）募集配套资金具体方案

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份募集配套资金发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上交所。

2、发行方式和发行对象

本次募集配套资金的发行方式为向特定对象发行。发行对象均以现金方式认购本次募集配套资金发行股份。

本次募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定条件的合计不超过 35 名（含 35 名）特定投资者。

最终发行对象将由董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权在取得中国证监会的注册同意文件后，与本次交易的独立财务顾问（主承销商）根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况确定。

3、定价基准日和发行价格

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%且不低于上市公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东的每股净资产。

本次发行股份募集配套资金采取询价发行方式，最终发行价格将在本次交易经上交所审核通过并经中国证监会注册后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权与本次发行的独立财务顾问（主承销商）根据竞价结果协商确定。

公司在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次募集配套资金的发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。

4、募集配套资金金额及发行数量

本次募集配套资金总额为不超过 210,500.00 万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。最终以经上交所审核通过并经中国证监会作出注册决定的募集资金金额及发行股份数量为上限。最终发行数量将在本次交易经上交所审核通过并经中国证监会注册后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

在募集配套资金定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会及上交所的相关规则作相应调整，股份发行数量也随之进行调整。

5、锁定期安排

本次募集配套资金发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

本次募集配套资金完成后，若本次发行股份募集配套资金的发行对象由于上市公司派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项而新增取得的上市公司股份，其锁定期亦应遵守上述约定。

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，则本次发行股份募集配套资金的发行对象将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述锁定期届满之后，本次募集配套资金的发行对象所取得的上市公司股份转让事宜按照中国证监会和上交所的有关规定执行。

6、滚存未分配利润安排

本次募集配套资金完成后，上市公司发行前的滚存未分配利润，由发行后新老股东按各自持股比例共同享有。

7、募集资金用途

本次募集配套资金总额不超过 210,500.00 万元，拟用于补充流动资金、支付本次交易的现金对价及中介机构费用，募集配套资金具体用途如下：

单位：万元			
序号	项目	拟使用募集资金金额	使用金额占全部募集配套资金金额的比例
1	补充流动资金	175,000.00	83.14%
2	支付本次交易的现金对价及中介机构费用	35,500.00	16.86%
合计		210,500.00	100.00%

本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但募集配套资金成功与否或是否足额募集不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。若证券监管机构的最新监管意见发生调整，则上市公司可根据相关证券监管机构的最新监管意见对本次募集配套资金相关事项进行相应调整。

在募集配套资金到位之前，上市公司可以根据实际情况以自有和/或自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。如上市公司未能成功实施募集配套资金或实际募集资金金额小于募集资金用途的资金需求量，上市公司将通过自有或自筹资金解决资金缺口，届时上市公司将根据实际募集资金净额，结合募集资金用途的实际需求，对上述募集资金用途的资金投入顺序、金额及具体方式等事项进行适当调整。

8、决议有效期

与本次募集配套资金方案有关的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册文件，则该有效期自动延长至本次交易实施完成之日。

三、本次交易构成重大资产重组

本次交易中上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买新昇晶投 46.7354%股权、新昇晶科 49.1228%股权和新昇晶睿 48.7805%股权。

根据《重组管理办法》第十四条规定：“上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

最近 12 个月内，上市公司通过全资子公司与其他方共同出资，投资设立控股子公司晋科硅材料。根据《重组管理办法》的规定，前述投资涉及标的资产与新昇晶投、新昇晶科、新昇晶睿均从事半导体硅片制造，属于相同或者相近业务范围，需纳入本次交易的累计计算范围。

根据本次交易标的资产、上市公司最近 12 个月购买资产与上市公司 2024 年度经审计的财务数据及交易作价情况，相关比例计算如下：

单位：万元			
项目	资产总额及交易金额 孰高	资产净额及交易金额 孰高	营业收入
新昇晶投 46.7354%股权	382,886.24	185,156.68	53,080.45
新昇晶科 49.1228%股权	381,585.96	381,585.96	29,717.38
新昇晶睿 48.7805%股权	137,219.51	137,219.51	4,247.02
本次交易标的资产合计	901,691.72	703,962.15	87,044.85
最近 12 个月购买资产晋科硅材料	250,000.00	250,000.00	不适用
累计计算	1,151,691.72	953,962.15	87,044.85

项目	资产总额及交易金额 孰高	资产净额及交易金额 孰高	营业收入
上市公司	2,926,984.24	1,229,926.01	338,761.17
指标占比	39.35%	77.56%	25.70%

注 1：资产净额为归属于母公司所有者的所有者权益。标的资产的资产总额、营业收入及资产净额为标的公司数据乘以标的资产对应的股权比例；同时，考虑到新昇晶投对新昇晶科并表、新昇晶科对新昇晶睿并表，计算资产总额及营业收入指标时已剔除重复计算影响。

注 2：2024 年 6 月 11 日，上市公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于子公司对外投资设立控股子公司实施太原项目的议案》，拟通过全资子公司出资 280,000.00 万元，与其他方共同出资设立晋科硅材料。2024 年 12 月 31 日，上市公司全资子公司将对晋科硅材料的 30,000.00 万元出资额（实际缴纳的出资额为 0 万元）转让给上海国际投资，前述转让后上市公司全资子公司的最终认缴出资额为 250,000.00 万元。

根据上表测算情况，标的公司及上市公司最近 12 个月购买资产累计的资产净额和交易作价孰高值占上市公司相关财务数据的比例高于 50%。因此，本次交易构成上市公司的重大资产重组。

由于本次交易涉及发行股份购买资产，根据《重组管理办法》规定，本次交易需经上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。

四、本次交易构成关联交易

本次交易的交易对方海富半导体基金的间接出资人中包含上市公司部分董事及高级管理人员，以及晶融投资的间接出资人中包含上市公司部分原监事（已于 2025 年 8 月 15 日经上市公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过取消设立监事会）。本次交易的交易对方产业基金二期的董事张新、杨高峰、唐雪峰、李国华同时担任持有上市公司 5%以上股份的主要股东产业投资基金的董事，产业基金二期的监事范冰同时担任产业投资基金的董事。华芯投资管理有限责任公司作为基金管理人根据各自的委托管理协议分别对产业投资基金、产业基金二期进行管理。根据实质重于形式原则，产业基金二期系上市公司关联方，且本次交易完成后，产业基金二期持有上市公司股份比例预计将超过 5%。因此，根据《上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

上市公司董事会审议本次交易相关议案时，关联董事已回避表决；上市公司股东大会审议本次交易相关议案时，关联股东已回避表决。

五、本次交易不构成重组上市

本次交易前上市公司无控股股东、实际控制人。本次交易完成后，上市公司仍无控股股东、实际控制人，本次交易预计不会导致上市公司控制权发生变更。根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。

第二节 本次交易的实施情况

一、本次交易决策过程和批准情况

截至本公告书摘要出具日，本次交易已经履行的决策和审批程序包括：

1、本次交易方案已经上市公司第二届董事会第二十六次会议、第二届董事会第二十九次会议审议通过；

2、本次交易方案已取得上市公司持股 5%以上股东的原则性意见；

3、本次交易方案已经交易对方有权内部决策机构授权或批准；

4、本次交易方案已经标的公司董事会和股东会审议批准；

5、本次交易方案已经上市公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过；

6、本次交易涉及的标的资产评估报告已经有权国有资产监督管理部门备案；

7、本次交易已经上交所审核通过；

8、本次交易已经中国证监会同意注册。

截至本公告书摘要出具日，本次交易已经完成所需履行的决策和审批程序，不存在尚需履行的决策和审批程序。

二、本次交易的实施情况

（一）本次交易的资产交割和过户情况

本次交易的标的资产为新昇晶投 46.7354%股权、新昇晶科 49.1228%股权及新昇晶睿 48.7805%股权。

1、新昇晶投过户情况

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局已于 2025 年 10 月 20 日向新昇晶投换发新的《营业执照》。截至本公告书摘要出具日，海富半导体基金和晶融投资合计持有的新昇晶投 46.7354%股权已全部过户登记至上市公司名下，新昇晶投的股权过户事宜已办理完毕，新昇晶投成为上市公司直接及间接持股的全资子公司。

2、新昇晶科过户情况

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局已于 2025 年 10 月 21 日向新昇晶科换发新的《营业执照》。截至本公告书摘要出具日，产业基金二期和上海闪芯合计持有的新昇晶科 49.1228%股权已全部过户登记至上市公司名下，新昇晶科的股权过户事宜已办理完毕，新昇晶科成为上市公司直接及间接持股的全资子公司。

3、新昇晶睿过户情况

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局已于 2025 年 11 月 20 日向新昇晶睿换发新的《营业执照》。截至本公告书摘要出具日，中建材新材料基金、上海国际投资和混改基金合计持有的新昇晶睿 48.7805%股权已全部过户登记至上市公司名下，新昇晶睿的股权过户事宜已办理完毕，新昇晶睿成为上市公司直接及间接持股的全资子公司。

（二）发行股份及支付现金购买资产实施情况

2025 年 9 月 26 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海硅产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2140 号），同意上市公司向海富半导体基金发行 104,489,404 股股份、向产业基金二期发行 226,983,180 股股份、向上海闪芯发行 24,514,183 股股份、向中建材新材料基金发行 46,623,551 股股份、向上海国际投资发行 27,425,618 股股份、向混改基金发行 17,369,558 股股份购买相关资产的注册申请。

根据登记结算公司提供的《证券变更登记证明》，上市公司已于 2025 年 11 月 25 日办理完毕本次发行股份及支付现金购买资产的新增股份登记，新增股份 447,405,494 股，登记后股份总数 3,194,582,680 股。

（三）验资情况

2025 年 11 月 20 日，立信对公司本次发行股份及支付现金购买资产进行了验资，并出具了《上海硅产业集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第 ZA15174 号）（以下简称“《验资报告》”）。根据《验资报告》，经审验，截至 2025 年 11 月 20 日，公司已收到海富半导体基金、产业基金二期、上海闪芯、中建材新材料基金、上海国际投资、混改基金缴纳的新增注册资本人民币 447,405,494.00 元，变更后公司的累计注册资本为人民币 3,194,582,680.00 元，股本为人民币 3,194,582,680.00 元。

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

上市公司就本次交易履行了相关信息披露义务，符合相关法律、法规和规范性文件的要求。截至本公告书摘要出具日，本次交易实施过程中，不存在与已披露信息存在重大差异的情形。

四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况

截至本公告书摘要出具日，本次交易实施过程中，上市公司的董事、高级管理人员不存在因本次交易而发生更换的情况。

截至本公告书摘要出具日，鉴于标的公司股东的变化情况，标的公司的董事、监事变更情况如下：

1、根据新昇晶投 2025 年第四次股东会、2025 年第五次股东会决议，新昇晶投不再设置董事会及监事会，改设一名执行董事、一名监事，并同意由李炜、赵雪洋分别担任新昇晶投执行董事、监事职务。

2、根据新昇晶科 2025 年第四次股东会、2025 年第五次股东会决议，新昇晶科不再设置董事会及监事会，改设一名执行董事、一名监事，并同意由李炜、赵雪洋分别担任新昇晶科执行董事、监事职务。

3、根据新昇晶睿 2025 年第四次股东会、2025 年第五次股东会决议，新昇晶睿不再设置董事会及监事会，改设一名执行董事、一名监事，并同意由李炜、赵雪洋分别担任新昇晶睿执行董事、监事职务。

截至本公告书摘要出具日，除前述变动外，标的公司的高级管理人员不存在因本次交易而发生更换的情况。

五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被持股 5%以上主要股东或其他关联人占用的情形，或上市公司为持股 5%以上股东及其关联人提供担保的情形

截至本公告书摘要出具日，本次交易实施过程中，不存在上市公司资金、资产被持股 5%以上主要股东或其他关联人非经营性占用的情形，或上市公司为持股 5%以上主要股东及其关联人提供担保的情形。

六、相关协议及承诺的履行情况

截至本公告书摘要出具日，交易各方按照《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的相关协议及承诺的要求已履行或正在履行相关协议及承诺，未出现违反协议及承诺的情形。

七、本次交易后续事项的合规性及风险

截至本公告书摘要出具日，本次交易涉及的相关后续事项主要包括：

- 1、上市公司尚需按照本次交易相关协议的约定向相关交易对方支付现金对价；
- 2、上市公司尚需在中国证监会批复的有效期内择机发行股份募集配套资金，并按照规定办理前述发行涉及新增股份的相关登记、上市手续；
- 3、上市公司尚需就本次交易涉及的增加注册资本事项修改《公司章程》并办理变更登记、备案手续；
- 4、上市公司、标的公司及相关各方尚需继续履行本次交易的相关合同、协议及承诺；
- 5、上市公司及其他交易各方需根据相关法律法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务。

第三节 中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见

一、独立财务顾问意见

本次交易的独立财务顾问中金公司认为：

“1、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求。

2、截至本核查意见出具日，本次交易标的资产已过户至上市公司名下，上市公司已合法持有标的公司股权，标的资产过户程序合法、有效。

3、截至本核查意见出具日，本次发行股份及支付现金购买资产新增股份的验资及登记手续已办理完毕。

4、截至本核查意见出具日，本次交易实施过程中，未发现相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情况。

5、截至本核查意见出具日，本次交易实施过程中，上市公司董事、高级管理人员不存在因本次交易而发生更换的情况。标的公司存在董事、监事更换的情况，主要系考虑本次交易后标的公司股东变动情况进行的调整。

6、截至本核查意见出具日，本次交易实施过程中及实施后，不存在上市公司资金、资产被持股 5%以上主要股东或其他关联人非经营性占用的情形，亦不存在上市公司为持股 5%以上主要股东及其关联人提供担保的情形。

7、截至本核查意见出具日，本次交易各方已签署的各项协议及作出的相关承诺事项已切实履行或正在履行，未出现违反协议约定或承诺的行为。

8、在交易各方按照其签署的相关协议和做出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。”

二、法律顾问意见

本次交易的法律顾问嘉源认为：

“1、本次重组方案的内容符合《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的规定。

2、本次重组已经取得现阶段必需的授权和批准，本次重组相关协议约定的生效条件已得到满足，本次重组具备实施条件。

3、本次重组的标的资产已完成交割过户手续，公司已完成本次交易所涉新增注册资本的验资及新增股份登记手续，实施情况合法有效。

4、截至本法律意见书出具之日，公司已就本次重组履行了相关信息披露义务，符合相关法律、法规和规范性文件的要求；本次重组实施过程中未出现实际情况与此前披露信息存在重大差异的情形。

5、自公司取得中国证监会关于本次交易的注册批复后至本法律意见书出具之日，标的公司董事、监事因标的公司股东变化情况相应发生变动，标的公司高级管理人员不存在因本次交易而发生更换的情况。

6、截至本法律意见书出具之日，不存在上市公司的资金、资产被持股 5%以上主要股东或其他关联人非经营性占用的情形，也不存在上市公司为持股 5%以上主要股东或其他关联人提供担保的情形。

7、截至本法律意见书出具之日，本次重组相关方不存在违反本次重组相关协议约定及其已披露的承诺的情形。

8、在本次重组各方切实履行相关协议及承诺的基础上，本次重组后续事项的实施不存在实质性法律障碍。”

（本页无正文，为《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）》之盖章页）

上海硅产业集团股份有限公司

2025 年 11 月 26 日